

今 話題の「エッジAI」に最適！ インテル® Cyclone® V SoC FPGA 搭載 世界最小クラス SoM (システムオンモジュール)



インテル® Cyclone® V SoC

FX10A-168S-SV(HRS)168Pin×2

「KEIm」(呼称:ケイム)

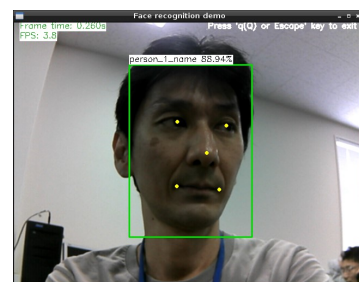
■特徴

- ・ARM® Cortex™-A9 MPCore™ プロセッサ搭載
- ・超小型プラットフォーム！製品の小型化が簡単に！
- ・SoC周辺回路が既に設計/評価済み
- ・エッジ AI の製品開発を容易にする開発環境
- ・試作から小中ロット量産まで対応可

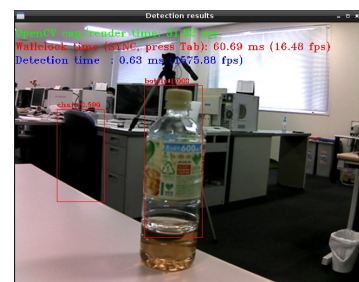
KEIm-CVSoC 開発キット をご購入後、即評価が可能です



【KEIm-CVSoC 評価イメージ】



【顔認証デモ画面】



【物体検出デモ画面】

本製品は、原則として日本国内での使用を想定して開発・製造しています。

本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、日本国および関係する諸外国の輸出関連法令を遵守し、手続きを行っていただきますようお願いいたします。

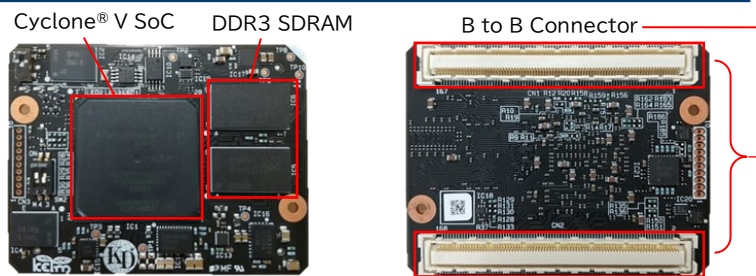


KEIm-CVSoC 製品仕様

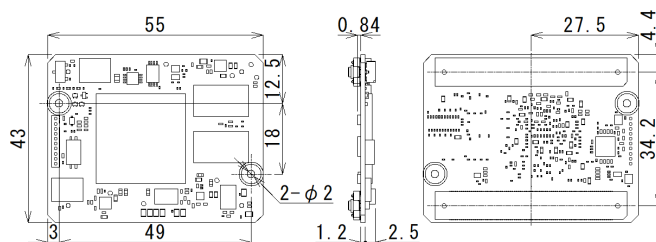
▼KEIm-CVSoC SoM 基本仕様

デバイス	5CSXFC5C6U23I7N ・Cyclone® V SX SoC FPGA ・SoC : ARM® Cortex™-A9 MPCore™ ・FPGA : 85K Logic Elements ・PCIe Hard IP Block x1
メモリ	DDR3 SDRAM 2GByte QSPI Flash 64MByte (HPS) QSPI Flash 32MByte (FPGA)
トランシーバ クロック	3.125Gbps Transceivers : Up to 6 25MHz (HPS), 50MHz (FPGA) 100MHz (Transceiver)
ペリフェラル	RTC, バッテリは外付け EEPROM(32kbit)
コネクタ	FX10A-168S-SV (HRS) 168pin x2 ・FPGA IO: Up to 133 ・HPS: Ethernet (RGMI) x1, USB2.0 OTG (ULPI) x1, SDMMC x1, SPIM x1, I2C x1, QSPI x1, UART x1, GPIO x21 ・JTAG (HPS, FPGA Chain)
入力電源	+3.3V±5%
消費電力	TBD
動作温度	TBD
外形寸法	55x43mm

▼SoM外観



▼SoM外形寸法 単位mm



▼開発キット外観



▼開発環境

開発ツール	インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェア インテル® SoC FPGA エンベデッド開発スイート
サンプルソフト	Webにて随時公開予定

(*)インテル® FPGA ダウンロード・ケーブル II は含まず

KEIm-CVSoC AI推論ソリューション ※オプション

(市場投入までの時間を大幅に短縮、「エッジAI」など主要分野と連絡した Pilot Ready ソリューション)

KEIm-CVSoC 開発キット



※筐体Type-M(標準) 外形:110 (W)×50 (H)×80 (D) mm

macnica

オプションに関するお問い合わせ: (株)マクニカ アルティマカンパニー
<https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/>

インテル® Movidius™ Myriad™ X



Mustang-M2BM-MX2

OR

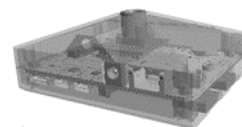
EFFICIERA®

LeapMind株式会社
超低消費電力AI推論
アクセラレータIP
「Efficiera」

(開発中)

筐体Type-I

外形:106 (W)×40.75(H)×78 (D) mm



LEAPMIND

Efficiera に関するお問い合わせ: LeapMind(株)
<https://leapmind.io/business/ip/>



株式会社 近藤電子工業

<http://www.kd-group.co.jp>

製品のご購入、受託に関するお問い合わせはこちら

✉ [【keim-support@kd-group.co.jp】](mailto:keim-support@kd-group.co.jp)